

●HSOP-8N パッケージ許容損失

HSOP-8N パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件（参考データ）

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

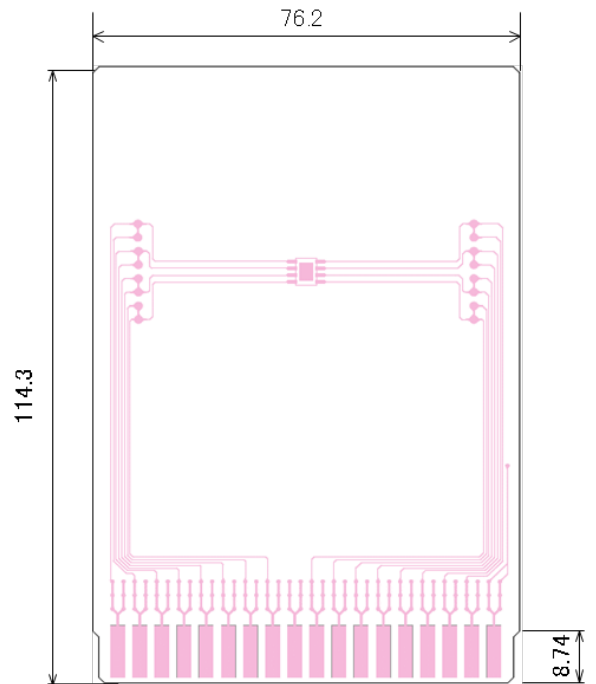
実装基板：4層基板 76.2mm×114.3mm（片面約 8700 mm²）に対して銅箔面積

- 1層目：銅箔無し（信号層の為）
- 2層目：74.2mm×74.2mm（放熱板と接続有）
- 3層目：74.2mm×74.2mm（放熱板と接続無）
- 4層目：銅箔無し（信号層の為）

基板材質：ガラスエポキシ（FR-4）

板厚：1.6mm

スルホール：φ0.3mm

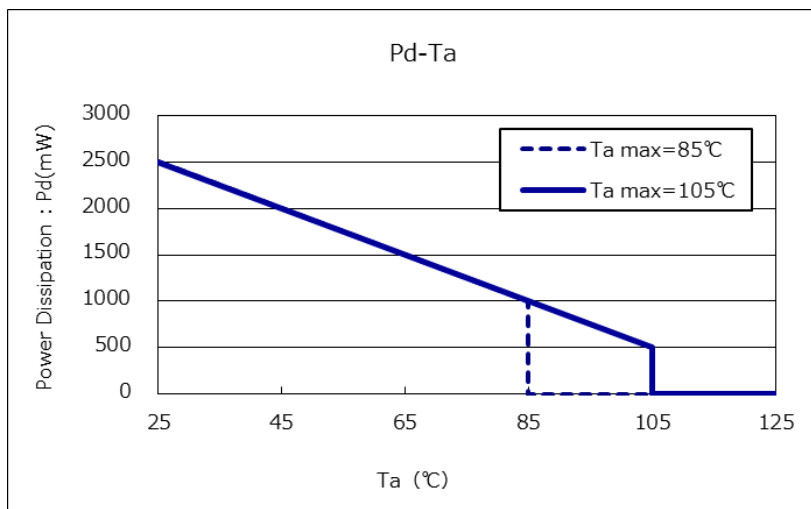


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)		熱抵抗(°C/W)
	Ta max=85°C	Ta max=105°C	
25	2500	2500	40.00
85	1000	1000	
105	0	500	
125	0	0	



●HSOP-8N パッケージ許容損失 ※Tjmax=150°C

HSOP-8N パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件（参考データ）

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基板：4層基板 76.2mm×114.3mm（片面約 8700 mm²）に対して銅箔面積

1層目：銅箔無し（信号層の為）

2層目：74.2mm×74.2mm（放熱板と接続有）

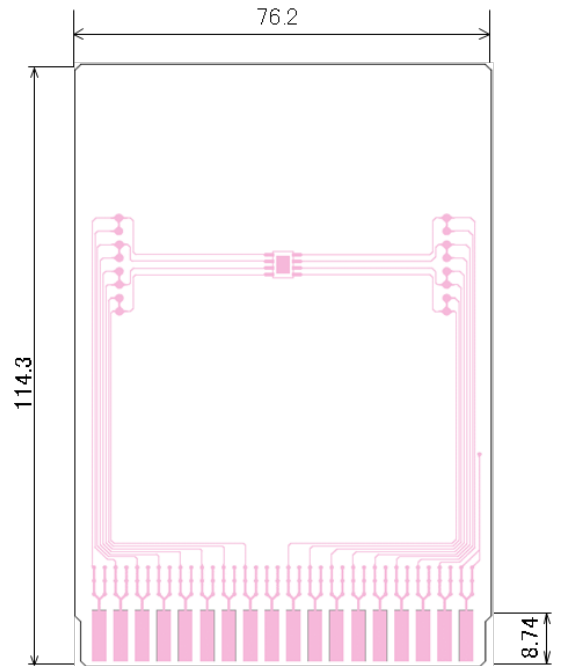
3層目：74.2mm×74.2mm（放熱板と接続無）

4層目：銅箔無し（信号層の為）

基板材質：ガラスエポキシ（FR-4）

板厚：1.6mm

スルホール：φ0.3mm



評価基板レイアウト(単位:mm)

2.許容損失-周囲温度特性

基板実装(Tjmax=150°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)		熱抵抗(°C/W)
	Ta max=125°C	Ta max=150°C	
25	3125	3125	40.00
125	625	625	
150	0	0	

